**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **研创光电科技(赣州)有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **19.01.01** |
| **教师姓名** | | **强兴** | **专业** | **19.01.01** | **培训地点** | **办公室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **张磊** |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 裁片→冲孔→填空→印刷→叠层→水压→排胶→烧结→切割→检验→入库。 | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | 关键过程：印刷过程；1、印刷前核对层别、浆料、网板、参数；2、印刷时每更换一块网板，都需要在试印纸上进行试印操作；3、印刷后需在显微镜下观察检查，每印刷5片需在厚膜测量仪下测量湿膜及干膜，厚度在标准范围内方可开始下一片印刷。  特殊过程：烧结过程；需检查烧结的产品型号、产品数量与随工单是否一致配对；烧结前检查烧结曲线，检查实际温度及链速是否稳定；将产品轻拿轻放，放入高温烧结炉的网筛中间位置进行烧结，设定温度曲线：设定温度曲线。 | | | | |
| **重要环境及控制措施** | |  | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | |  | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 电子陶瓷零件技术条件（GB9531.1-1988）、滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件GB/T15155-1994、电子陶瓷用氧化铝粉体材料GB/T15154-1994、厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片GB/T4619-2013、厚膜陶瓷基板生产工厂设计标准GB51333-2018等 | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 检验外观、规格、性能。 | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | |

****

**填表人(专业人员)： 日期： 审核组长： 日期：**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**